

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2021-017

天水华天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 2,740,003,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 华天科技 | 股票代码 | 002185 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 常文瑛 | 杨彩萍 | |
| 办公地址 | 甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号 | 甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号 | |
| 电话 | 0938-8631816 | 0938-8631990 | |
| 电子信箱 | htcwy2000@163.com | caiping.yang@ht-tech.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

受益于国产替代加速，2020 年集成电路市场景气度较 2019 年大幅提升，公司订单饱满，净利润创历史新高。

（二）公司所属行业情况

公司所属行业为集成电路行业，集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成集成电路设计后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产企业。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定的周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，与全球经济增长的联动性有所增强。

受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的发展，我国集成电路产业增长强劲。随着集成电路应用领域的不断拓展、技术水平的不断提高，以及在国家、地方相关产业政策与资本的有力支持和集成电路国产替代加速的背景下，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持良好发展势头，市场需求快速增长。国内集成电路产业技术不断提升和巨大的市场需求带动了集成电路设计业、制造业及封装测试业的持续发展。

根据中国半导体行业协会统计，2020 年我国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

根据国家统计局数据，2020 年我国集成电路产量达到 2,614.7 亿只，同比增长 29.6%，产量创下新高。虽然我国集成电路产业规模增长迅速，但集成电路产业进口依赖严重，已连续多年超过原油成为我国第一大进口商品。2020 年我国进口集成电路 5,435 亿只，同比增长 22.1%；进口金额 3,500.4 亿美元，同比增长 14.6%。2020 年我国集成电路出口 2,598 亿只，

同比增长 18.8%，出口金额 1,166 亿美元，同比增长 14.8%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入 | 8,382,084,225.00 | 8,103,490,628.12 | 3.44% | 7,121,706,261.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 701,709,840.59 | 286,794,698.21 | 144.67% | 389,826,128.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 531,812,331.74 | 151,608,683.08 | 250.78% | 307,687,586.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,058,108,186.81 | 1,765,034,058.08 | 16.60% | 1,133,031,257.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2561 | 0.1134 | 125.84% | 0.1639 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2561 | 0.1134 | 125.84% | 0.1639 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.70% | 4.30% | 4.40% | 7.07% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 19,309,122,269.13 | 16,044,968,730.79 | 20.34% | 12,442,682,421.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,506,631,614.77 | 7,768,107,631.71 | 9.51% | 5,694,557,262.53 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,692,152,931.08 | 2,022,418,264.05 | 2,202,685,192.70 | 2,464,827,837.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,655,326.48 | 204,321,407.30 | 180,392,561.72 | 254,340,545.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,727,459.22 | 161,527,162.84 | 164,525,545.33 | 157,032,164.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,760,318.78 | 345,478,891.11 | 788,844,040.88 | 712,024,936.04 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

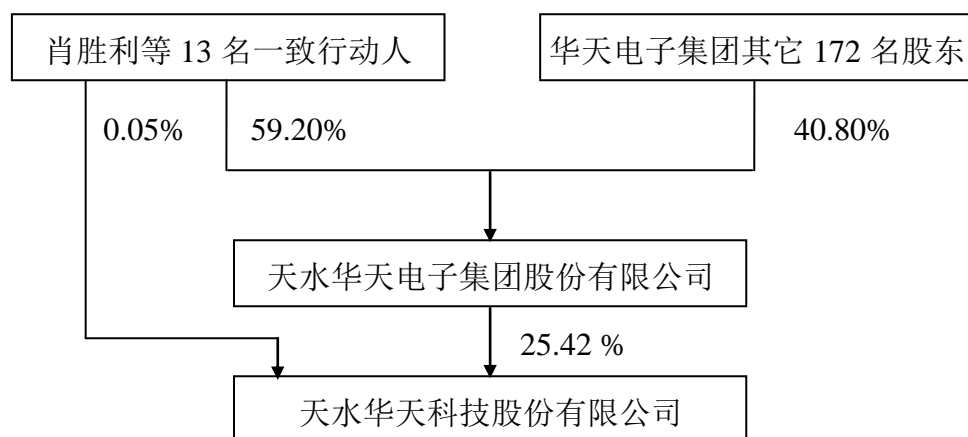
| 报告期末普通股股东总数 | 398,570 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 399,318 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 天水华天电子集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 25.42% | 696,472,455 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.16% | 59,066,445 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.86% | 50,924,815 | 0 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 33,477,432 | 0 | | | |
| 易建东 | 境内自然人 | 1.09% | 30,000,000 | 0 | | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 28,031,757 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 22,000,000 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.60% | 16,314,800 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 10,107,869 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 6,590,016 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>报告期末，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 51,850,317 股股份，占公司总股份的 1.89%；招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 23,564,947 股股份，占公司总股份的 0.86%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,358,600 股股份，占公司总股份的 0.67%；中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,004,568 股股份，占公司总股份的 0.66%。</p> <p>上述前 10 名股东中，易建东在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 30,000,000 股。</p> | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1) 概述

根据中国半导体行业协会引用WSTS（世界半导体贸易统计组织）数据，2020年全球半导体市场销售额4,390亿美元，同比增长6.5%，四季度的销售复苏抵消了3、4月份的大幅下滑。2020年全球半导体销售额虽然实现一定增长，但由于2019年降幅达到两位数，2020年仍未恢复到2018年水平。2020年新冠疫情的爆发，全球经济停滞不前，美国对我国重点企业进行的限制，对我国集成电路发展造成一定冲击，但得益于我国在新基建、5G手机等终端产品、测温仪等医疗电子设备为集成电路产品带来的市场需求，我国集成电路产业仍保持高速增长。

2020年公司高度关注疫情动态和行业发展形势变化，一方面积极开展疫情防控和复工复产，另一方面努力做好生产经营相关工作。报告期内，公司优化了部分封装产品的购销业务模式，在生产销售产品过程中，不再对该部分产品的芯片承担存货风险，对该部分收入按照会计准则的相关规定按净额法确认。2020年，公司共完成集成电路封装量394.50亿只，同比增长18.87%，晶圆级集成电路封装量107.65万片，同比增长26.42%，实现营业收入83.82亿元，同比增长3.44%，营业利润9.09亿元，同比增长155.04%。截至2020年12月31日，公司总资产193.09亿元，同比增长20.34%，归属于上市公司股东的净资产85.07亿元，同比增长

9.51%。2020年公司主要工作开展情况如下：

①继续发挥销售龙头作用，做好重点客户服务和交期保障工作，大力开拓战略新客户。

报告期内，公司持续关注疫情对集成电路行业的影响，抓住行业景气度持续提升的有利时机，加强与客户的沟通和订单跟踪的相关工作，推动重点客户、重点产品稳步上量，在订单饱满期间合理安排生产保障交期，Bumping、WLCSP、TSV-CIS、存储器等产品订单大幅增长。报告期内，公司新开发客户108家，客户结构优化工作稳步推进。

②借助与国际客户合作契机，以重点客户、专线产品带动公司整体质量水平提升。

通过联合稽查、覆盖性监控、专项改善等方式持续推进质量管理，建立各子公司质量管理经验分享的制程质量管理会议机制，总结借鉴汽车电子等重点客户、专线产品管理经验，巩固“产品实现全流程质量管理”的方法与成果，提升公司整体质量水平。报告期内，公司通过ISO45001、ISO27001、ESD20.20等体系认证，进一步完善质量管理体系架构。公司通过三家欧洲排名前十的汽车终端客户以及相关汽车电子客户的审核，汽车电子产品封装产量持续增长。

③持续进行封装技术研发工作，不断增强公司科技创新能力。

报告期内，公司持续进行先进封装技术的研发布局和投入。晶圆级12吋3:1 TSV直孔工艺、8吋2:1 TSV直孔工艺通过可靠性认证。基于Memory PiP技术的封装产品量产，3D NAND 16叠层SSD产品、基于Hybird(FC+WB)技术的UFS产品、NAND和DRAM合封的MCP产品、Micro SD卡产品等存储类产品通过可靠性认证，具备量产条件。基于FC封装技术的DDR4通过认证。持续提升单颗HFCBGA产品封装能力，基于12nm工艺的FCBGA AI芯片和40mm×40mm FCBGA产品量产。完成框架类5G基站砷化镓多芯片+电容芯片混合封装PA产品开发，5G手机射频高速SiP封装产品已量产。完成侧面指纹产品、传感器环境光透明塑封工艺、温度传感器灌胶工艺、压力传感器隐形切割工艺开发，具备量产能力。车规级胎压传感器通过认证。

报告期内公司共获得国内专利授权30项，其中发明专利13项；美国专利授权1项。

④华天南京一期顺利投产，扩大了公司产业规模和未来发展空间。

华天南京于2020年7月18日举行了一期项目投产仪式，标志着华天南京正式进入生产经营阶段。按照公司对华天南京“高质量赢客户”的发展要求，华天南京建立健全内部规章制度，全面推动IT系统建设，通过封装测试相关的体系认证和现场审核，重点客户工程批100%一次性考核通过。华天南京的存储器、滤波器、MEMS等封装产品已向客户批量供货。

⑤业务流程变革和数字化转型工作持续推进，公司运营能力进一步提升。

按照业务流程变革和数字化转型项目实施推进计划，梳理战略、营销、销售、服务、采购业务管理模式，并结合行业及公司定位，修订公司愿景和使命、价值观。启动并推进战略规划到执行流程、市场洞察流程以及面向高端客户的变革项目的实施，分析内部差距、识别外部机遇，持续关注创新焦点和关键业务举措，稳步提升公司运营管理能力。

(2) 主营业务分析

①营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 8,382,084,225.00 | 100% | 8,103,490,628.12 | 100% | 3.44% |
| 分行业 | | | | | |
| 集成电路 | 8,233,113,899.95 | 98.22% | 7,861,032,171.55 | 97.01% | 4.73% |
| LED | 148,970,325.05 | 1.78% | 242,458,456.57 | 2.99% | -38.56% |
| 分产品 | | | | | |
| 集成电路 | 8,233,113,899.95 | 98.22% | 7,861,032,171.55 | 97.01% | 4.73% |
| LED | 148,970,325.05 | 1.78% | 242,458,456.57 | 2.99% | -38.56% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 4,353,465,139.10 | 51.94% | 3,357,948,458.99 | 41.44% | 29.65% |
| 国外销售 | 4,028,619,085.90 | 48.06% | 4,745,542,169.13 | 58.56% | -15.11% |

②营业成本构成

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 集成电路 | 营业成本 | 6,397,897,384.56 | 97.46% | 6,571,140,210.77 | 96.92% | -2.64% |
| LED | 营业成本 | 166,962,851.09 | 2.54% | 209,151,772.44 | 3.08% | -20.17% |

③产量、销量情况

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 集成电路 | 销售量 | 万只 | 3,951,732 | 3,263,147 | 21.10% |
| | 生产量 | 万只 | 3,944,991 | 3,318,763 | 18.87% |
| | 库存量 | 万只 | 127,925 | 134,666 | -5.01% |
| 集成电路 | 销售量 | 片 | 1,045,272 | 855,676 | 22.16% |
| | 生产量 | 片 | 1,076,536 | 851,539 | 26.42% |
| | 库存量 | 片 | 59,000 | 27,736 | 112.72% |
| LED | 销售量 | 万只 | 909,698 | 1,236,908 | -26.45% |
| | 生产量 | 万只 | 944,988 | 1,322,096 | -28.52% |
| | 库存量 | 万只 | 175,928 | 140,638 | 25.09% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司晶圆级封装产品发展迅速，产销存量均有增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 集成电路 | 8,233,113,899.95 | 1,835,216,515.39 | 22.29% | 4.73% | 42.28% | 5.88% |
| LED | 148,970,325.05 | -17,992,526.04 | -12.08% | -38.56% | -154.02% | -25.82% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润 701,709,840.59 元,较去年同期增长 144.67%,主要原因为受益于国产替代加速,2020 年集成电路市场景气度较 2019 年大幅提升,公司订单饱满,经营业绩大幅上升所致。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见审计报告附注五、(二十八)。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并范围发生变化的情况。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇二一年三月三十日